

NO&T U.S. Law Update

米国最新法律情報

2025 年 3 月

米国最新法律情報 No.138

国際通商・経済安全保障ニュースレター No.26

米国輸出管理規制アップデート～2024 年 12 月対中国向け半導体輸出規制の拡大～

弁護士・ニューヨーク州弁護士 塚本 宏達
弁護士・ニューヨーク州弁護士 伊佐次 亮介

はじめに

2024 年 12 月 2 日、米国商務省産業安全保障局（the U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security、以下「BIS」といいます。）は、既存の先端コンピューティング及び半導体製造関連品目に関する輸出管理規則（Export Administration Regulations、以下「EAR」といいます。）を改訂・拡大する最終暫定規則案（Foreign-Produced Direct Product Rule Additions, and Refinements to Controls for Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items¹、以下「本規則案」といいます。）を公表しました。本規則案は、中国による次世代先端兵器システムや軍事的に重要な用途を有する人工知能（AI）・先端コンピューティングに利用可能な先端ノード半導体（advanced-node semiconductors）を生産する能力を制限することを主たる目的としており、①新たな直接製品規制の追加、②先端ノード集積回路（advanced-node IC）の製造に必要な一定の装置や関連品目に関する規制の拡大、③HBM（High Bandwidth Memory）に関する規制の追加、④ソフトウェアライセンスキーに関する規制の追加等を定めるものとなっています。

また、同日、BIS は、エンティティ・リスト²に新たに 140 の主体を追加すること、16 の主体をエンティティ・リストの脚注 5 付掲載者へ変更すること、認証最終需要者プログラム（Validated End-User Program）から 3 当事者を除外すること等を規定した最終規則（Additions and Modifications to the Entity List; Removals from the Validated End-User (VEU) Program³）を合わせて公表しています。

これまで、BIS は、軍事-民生融合（Military-Civil Fusion）を通じ 2049 年までに世界最高水準の軍事力を達成するという中国の国家目標を米国の国家安全保障に対する重大な脅威と認定し、半導体が当該中国の国家目標に果たす役割の重要性を鑑み、一貫して対中国向けの半導体関連の輸出規制の強化を続けています。①2022 年 10 月

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/05/2024-28270/foreign-produced-direct-product-rule-additions-and-refinements-to-controls-for-advanced-computing>

² エンティティ・リストとは、EAR のもとで整備されている、米国の国家安全保障や外交政策に反する活動に関与していると考えられる個人、法人及び団体等のリストのことをいいます。エンティティ・リスト及びエンティティ・リスト掲載者への輸出規制の詳細は、当事務所発行の米国最新法律情報 No.53「米国輸出管理規制アップデート～エンティティ・リストの更新と FAQs の公表～」(2021 年 1 月)をご確認ください。

³ <https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/05/2024-28267/additions-and-modifications-to-the-entity-list-removals-from-the-validated-end-user-veu-program>

7日に公表した暫定最終規則案(Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification⁴)では、先端コンピューティング用集積回路、一定の半導体製造装置、スーパーコンピュータに関連する取引等を広く EAR の規制対象とし⁵、②2023 年 10 月 17 日に公表した 2 つの暫定最終規則案(Export Controls on Semiconductor Manufacturing Items⁶及び Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Updates and Corrections⁷)では、①の規制の迂回を防止し EAR によるコントロールの実効性を高める観点から、先端コンピューティング及び半導体製造装置関連の規制の明確化・更なる規制強化が図られてきましたが⁸、本規則案は①②を中心とした対中国向けの輸出管理における規制強化の延長に位置付けられるものとなっています。以下、本規則案の概要・ポイントをご説明いたします。

新たな直接製品規制の追加

1. エンティティ・リストの脚注 5 付掲載者向けの直接製品に関する新規制 (§ 734.9(e)(3))

(1) 概要

本規則案は、以下の①製品条件及び②エンドユーザー条件を満たす場合、非米国産の半導体製造装置及び関連する製品について、新たな直接製品規制を通じて EAR の規制対象とすることを規定しています。新たな直接製品規制の適用がある場合、中国向けに限らず、全世界への輸出・再輸出・国内移転がライセンスの対象となる可能性があり、例えば日本国内企業に対する日本国内における移転を前提とした取引であっても、最終的に当該移転先企業によって脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者向けの製品に組み込まれることを知り得る場合については、ライセンスが必要となる場合があります。

①製品条件

(i) ECCN 3B001 (3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、g、h、k から n、p.2、p.4 及び r を除く)、3B002 (3B002.c を除く)、3B903、3B991 (3B991.b.2.a から 3B991.b.2.b を除く)、3B992、3B993 又は 3B994 に該当する非米製産品 (commodity⁹) であること、かつ

(ii) 以下のいずれかの条件を満たすこと

(a) ECCN 3D001 (3B に該当する製品ののための)、3D901 (3B903 のための)、3D991 (3B991 及び 3B992 のための)、3D993、3D994、3E001 (3B に該当する製品ののための)、3E901 (3B903 のための)、3E991 (3B991 及び 3B992 のための)、3E993 又は 3E994 に該当する EAR 対象品目の技術又はソフトウェアの直接製品であること

(b) ECCN 3D001 (3B に該当する製品ののための)、3D901、3D991 (3B991 及び 3B992 のための)、3D992、3D993、3D994、3E001 (3B に該当する製品ののための)、3E901 (3B903 のための)、3E991 (3B991 及び 3B992 のための)、3E992、3E993 又は 3E994 に該当する米国産の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外に所

⁴ <https://www.federalregister.gov/documents/2022/10/13/2022-21658/implementation-of-additional-export-controls-certain-advanced-computing-and-semiconductor>

⁵ 2022 年 10 月 7 日に公表した暫定最終規則案の詳細は、当事務所発行の[米国最新法律情報 No.82「米国輸出管理規制アップデート～対中輸出規制の強化～」](#)(2022 年 11 月)をご確認ください。

⁶ <https://www.federalregister.gov/documents/2023/10/25/2023-23049/export-controls-on-semiconductor-manufacturing-items>

⁷ <https://www.federalregister.gov/documents/2023/10/25/2023-23055/implementation-of-additional-export-controls-certain-advanced-computing-items-supercomputer-and>

⁸ 2023 年 10 月 17 日に公表した 2 つの暫定最終規則案の詳細は、当事務所発行の[米国最新法律情報 No.107/国際通商・経済安全保障 ニュースレター No.13「米国輸出管理規制アップデート～先端コンピューティング及び半導体製造装置関連の輸出管理規制の強化～」](#)(2023 年 12 月)をご確認ください。

⁹ 装置や特定の目的のために設計された部品・部材・アクセサリ等が含まれることとされていますが、技術やソフトウェアは“Commodity”の定義から除かれています (§ 772.1)。

在する工場又は工場の主要な要素（設備等）によって生産されたこと

(c) ECCN 3D001（3B に該当する製品ののための）、3D901、3D991（3B991 及び 3B992 のための）、3D992、3D993、3D994、3E001（3B に該当する製品ののための）、3E901（3B903 のための）、3E991（3B991 及び 3B992 のための）、3E992、3E993 又は 3E994 に該当する米国産の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外に所在する工場又は工場の主要な要素（設備等）によって生産された非米国産の製品を含むこと

②エンドユーザー条件

(i) 脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者が製造、購入若しくは発注する部品、部材若しくは装置に組み込まれることを知っている（“knowledge”）若しくは知り得る場合、又は

(ii) 脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者が当該非米国産品目の取引に関与することを知っている（“knowledge”）若しくは知り得る場合

上記①(ii)(c)は、従来の直接製品規制には見られなかった新たなタイプの要件となっており、非米国産の品目であり、かつ、当該品目に含まれる集積回路が非米国産の場合であっても、当該集積回路が一定の ECCN に該当する米国産の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外に所在する工場生産された場合には、上記製品条件を満たすこととなります¹⁰。そのため、米国産の半導体製造装置やソフトウェアにより製造された集積回路を含む非米国産の半導体製造装置は、広く本直接製品規制の対象に含まれることとなります。また、BIS は、①(ii)(c)の要件の判断に関して、Supplement No.3 to Part 732 の Red Flag に新たな内容（Red Flag 26）を追加しています。すなわち、集積回路の開発及び生産において米国由来の特定の半導体製造装置及びソフトウェアが広く使われている実態を踏まえ、非米国産品目が①(i)に規定する産品に該当し、かつ、当該産品が少なくとも 1 つ以上の集積回路を含む場合、①の製品条件を満たす Red Flag に該当することとされています。

(2) 0%デミニミスルール（§ 734.4(a)(9)）

本規則案は、脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者向けの直接製品に関する新規制の導入に合わせて、3B の ECCN カテゴリーに該当する非米国製産品（3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、g、h、k から n、p.2、p.4、r 及び 3B002.c を除く）について、当該産品が CCL のカテゴリー3、4 又は 5 に特定された米国産の集積回路を含む場合であり、かつ、当該産品が脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者向けの場合について、米国原産品目の全体に占める価額に関わらず当該産品を EAR 対象品目とするいわゆる 0%デミニミスルールを追加しています。当該追加により、脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者向けの産品の場合、米国原産の集積回路が含まれている場合はいかなるレベルであっても EAR 対象品目となります。

(3) 許可要件（§ 744.11(a)(2)(v)(A)）

脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者向けの直接製品ルールにより EAR の規制対象となった産品は、以下の状況を満たす場合において、その輸出・再輸出・国内移転につき輸出許可が必要となります。

① ECCN 3B993 に該当する産品

- マカオ又はカントリー・グループ¹¹「D:5」に指定されている国に本社を置く主体又は当該国に本社を置く主体が最終親会社である主体による外国からの輸出又は再輸出
- Supplement No. 4 to Part 742 に記載されていないカントリー・グループ「A:5」に属する国（その国が当該産品に同等の規制を課していない場合に限り）からの輸出又は再輸出
- 「A:5」に指定されていない国からの Supplement No. 4 to Part 742 に属する国に本社を置く主体による外国からの輸出又は再輸出
- Supplement No. 4 to Part 742 に属する国に本社を置く主体が最終親会社である主体による、脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者が所在する国における国内移転

¹⁰ § 734.9(e)(3)(i)(B)(2)の Note 3 も参照。

¹¹ <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/2255-supplement-no-1-to-part-740-country-groups-1/file>

- ② ECCN 3B001 (3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、g、h、k から n、p.2、p.4 及び r を除く)、3B002(3B002.c を除く)、3B611、3B903、3B991 (3B991.b.2.a から 3B991.b.2.b を除く)、3B992、3B993 又は 3B994 に該当する産品
- 「A:5」に指定されていない国からの Supplement No. 4 to Part 742 に属さない国に本社を置く主体による外国からの輸出又は再輸出
 - Supplement No. 4 to Part 742 に属さない国に本社を置く主体が最終親会社である主体による、脚注 5 付エンティティ・リスト掲載者が所在する国における国内移転

2. 半導体製造装置の直接製品に関する新規制 (§ 734.9(k))

(1) 概要

本規則案は、以下の①製品条件及び②仕向地条件を満たす場合、非米国産の半導体製造装置及び関連する品目について、新たな半導体製造装置の直接製品規制を通じて EAR の規制対象とすることを規定しています。

①製品条件

- (i) ECCN 3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、k から n、p.2、p.4、r、又は 3B002.c に該当する非米国製産品であること、かつ
- (ii) 以下のいずれかの条件を満たすこと
- (a) EAR 対象品目であり、かつ、ECCN 3D992 又は 3E992 に該当する技術又はソフトウェアの直接製品であること
- (b) ECCN 3D001 (3B に該当する産品のための)、3D901、3D991 (3B991 及び 3B992 のための)、3D992、3D993、3D994、3E001 (3B に該当する産品のための)、3E901 (3B903 のための)、3E991 (3B991 及び 3B992 のための)、3E992、3E993 又は 3E994 に該当する米国産の技術又はソフトウェアの直接製品である工場又は工場の主要な要素（設備等）によって生産されたこと
- (c) ECCN 3D001 (3B に該当する産品のための)、3D901、3D991 (3B991 及び 3B992 のための)、3D992、3D993、3D994、3E001 (3B に該当する産品のための)、3E901 (3B903 のための)、3E991 (3B991 及び 3B992 のための)、3E992、3E993 又は 3E994 に該当する米国産の技術又はソフトウェアの直接製品である工場又は工場の主要な要素（設備等）によって生産された非米国産の製品を含むこと

②仕向地条件

仕向地がマカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国であることを知っている（“knowledge”）又は知り得る場合

(2) 0%デミニミスルール (§ 734.4(a)(8))

上記 1(2)と同様、本規則案は、新たな半導体製造装置の直接製品規制の導入に合わせて、3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、g、h、k から n、p.2、p.4、r 又は 3B002.c に該当する非米国製産品について、当該産品が CCL のカテゴリー3、4 又は 5 に特定された米国産の集積回路を含む場合、かつ、当該産品がマカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国向けの場合、米国原産品目の全体に占める価額に関わらず、当該産品を EAR 対象品目とする、いわゆる 0%デミニミスルールを追加しています（但し、National Security（国家安全保障規制）の許可要件の例外 (§ 742.4(a)(4)) 又は Regional Stability（地域安定規制）の許可要件の例外 (§ 742.6(a)(6)) に該当する場合は除くこととされています。）。

(3) 許可要件 (§ 742.6(a)(6))

§ 742.6(a)(6)は、ECCN 3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、k から n、p.2、p.4、r、又は 3B002.c に該当する品目（①(i)に列挙された類型の品目）並びに関連するソフトウェア又は技術をマカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国に輸出・再輸出・国内移転する場合、Regional Stability（地域安定規制）を根拠に輸出許可の取得

が必要である旨を規定していますが、本規則案は当該許可要件を維持しています。

RFF 許可例外の追加

本規則案は、旧型の半導体製造装置を含む一定の EAR 対象品目について、エンティティ・リストに掲載されているものの、先端ノード集積回路の製造を行っていないと BIS が判断した主体に対する輸出・再輸出・国内移転を許可するための「制限製造施設」(Restricted Fabrication Facility) 向けの許可例外（以下「RFF 許可例外」といいます。）を新たに規定しています (§ 740.26)。RFF 許可例外では、ECCN 3B001、3B002、3B993、3B994、3D992、3D993、3D994、3E992、3E993 又は 3E994 に該当しない EAR 対象品目を「制限製造施設」に輸出・再輸出・国内移転する場合、①当該品目が先端ノード集積回路の製造に利用されないこと、及び②「制限製造施設」における ECCN 3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、k から n、p.2、p.4、r、3B002.c、3B993 又は 3B994 の稼働、備え付け、メンテナンス等に利用されないことを条件として、輸出許可の取得が不要となります。但し、RFF 許可例外によっても、Part 742 が規定する仕向地に基づく許可要件又は Part 744 が規定するエンドユーザーに基づく許可要件をクリアすることは出来ないとされているため、これらの許可要件に基づき輸出許可が必要となる場合、RFF 許可例外を利用することは出来ません。

なお、本ニュースレター発行時点において、エンティティ・リスト上で「制限製造施設」として指定されているのは、Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Company Limited のみとなっています。

エンドユース規制の拡大

1. 半導体製造装置に関するエンドユース規制の拡大 (§ 734.23(a)(2)及び(4))

本規則案は、§ 734.23 が規定する半導体製造装置に関するエンドユース規制の対象を、以下のとおり拡大しています。

- ① EAR の規制対象となる電子コンピュータ支援設計 (ECAD) 又は技術コンピュータ支援設計 (TCAD) のソフトウェア及び技術の輸出・再輸出・国内移転を行う場合、マカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定されている国で生産される先端ノード集積回路の設計に使用されることを知っている又は知り得る場合は上記エンドユース規制の対象とする (§ 734.23(a)(2)(ii))。
- ② § 734.23(a)(4)(i)の許可要件 (EAR 対象であり、かつ、一定の半導体製造装置の部品、部材等の開発又は生産を目的とした最終用途でマカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国向けに輸出される場合の全ての品目を対象とする。)を拡大するため、フロントエンド (前工程) の要件が廃止され、対象となる一定の半導体製造装置のリストを更新し、新たな ECCN 項目を追加。その結果、EAR の対象であり、かつ、CCL に記載されている物品が、マカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国向けに一定の半導体製造装置の部品、部材等の開発又は生産等に使用される場合、例えば当該半導体製造装置が集積回路の性能を変更しないバックエンド (後工程) での使用を目的とするものであっても、輸出許可が必要。

2. 先端ノード集積回路の定義の変更

上記エンドユース規制の拡大に伴い、対象となる先端ノード集積回路の定義が改訂され、先端ノード集積回路に含まれる DRAM の技術的要件が以下のとおり見直されました。

- ① メモリセルの面積が 0.0019 平方マイクロメートル (μm^2) 未満のもの、又は
- ② メモリ密度が平方ミリメートルあたり 0.288 ギガビットを超えるもの

ECCN の追加・改訂

1. HBM (High Bandwidth Memory)

(1) ECCN 3A090.c の追加

HBM は、非常に高いデータ転送速度を持った DRAM であり、近年 AI やスーパーコンピュータ等の先端技術において欠かすことの出来ない半導体製造技術となっています。本規則案は、HBM の重要性に鑑み、ECCN 3A090 に新たに“.c”のカテゴリーを追加しています。当該追加により、非米国製の HBM は、先端コンピューティング直接製品規制 (§ 734.9(h)) の対象に含まれることとなります。ECCN 3A090.c において対象とされる HBM は、メモリ帯域幅密度 (width density) ¹²が 1 平方ミリメートルあたり 1 秒あたり 2 ギガバイトを超えるものと指定されており、現在製造されている HBM は全てこの基準を満たすこととされています。なお、集積回路又はコンピュータや電子アセンブリ等の高度な産品に組み込まれた HBM に関しては、ECCN 3A090.a 若しくは b、ECCN 4A090.a 若しくは b 又は各 ECCN の「.z」で管理される場合もあります。

(2) ECCN 3A090.c に関する許可要件の改訂・許可例外の追加 (§ 742.6(a)(6)(i)(B)、§ 740.25)

ECCN 3A090 の追加に伴い、本規則案は§ 742.6(a)(6)(i)(B)を改訂し、ECCN 3A090.c、3D001 (3A090.c のための) 及び 3E001 (3A090.c のための) に該当する HBM 関連の品目につきマカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国への輸出・再輸出・国内移転を行う場合、ライセンスの取得が必要であるとしています。他方で、本規則案は§ 740.25 として新たな許可例外を追加し、メモリ帯域幅密度が 1 平方ミリメートルあたり 1 秒あたり 3.3 ギガバイト未満の ECCN 3A090.c に該当する品目が、マカオ又はカントリー・グループ「D:5」に指定された国に最終親会社の本社が置かれていない米国又はカントリー・グループ「A:5」に指定された国の企業から輸出等がなされる場合、かつ、一定の条件を満たした場合には当該許可例外が利用出来る旨を規定しています。

2. 半導体製造装置

本規則案は、半導体製造装置及び関連するソフトウェア・技術に対する規制を拡大するため、新たに 8 つの ECCN (3B993、3B994、3D992、3D993、3D994、3E992、3E993 及び 3E994) を追加し、また、既存の 7 つの ECCN (3B001、3B002、3B991、3B992、3D001、3D002 及び 3E001) を改訂しています。各追加・改訂の内容は非常に技術的な要素を含んでいるため、本 NL においてその詳細は割愛しますが、特に半導体製造装置に関連する事業を行う日本企業においては、自社の品目管理として各 ECCN 該当性をあらためて検討する必要があります。

ソフトウェアキーに関する規制

本規則案は、§ 734.19 に新しいパラグラフ(b)を追加しています。当該パラグラフ(b)では、「ソフトウェアキー」又は「ソフトウェアライセンスキー」を、ソフトウェア又はハードウェアへのアクセスを提供したり、既存のソフトウェア又はハードウェアの利用ライセンスを更新したりすることで、ユーザーがソフトウェア又はハードウェアを使用出来るようにする機能を持つものと定義した上で、「ソフトウェアキー」又は「ソフトウェアライセンスキー」はそれらが利用を可能にするハードウェア又はソフトウェアと同じ ECCN で管理されることが明らかとされました。そのため、ハードウェア又はソフトウェアの輸出・再輸出・国内移転につきライセンスの取得が必要な場合は、対応する「ソフトウェアキー」又は「ソフトウェアライセンスキー」の提供についても同様にライセンスの取得が求められることとなります。

おわりに

本規則案に対し、2024 年 12 月 3 日、中国商務部は、輸出管理法等の関連法令に基づいて、米国向け両用品目

¹² 新たに追加された Technical Note によれば、「メモリ帯域幅密度」とは、1 秒あたりギガバイト単位で測定されたパッケージ又はスタックのメモリ帯域幅を、平方ミリメートル単位で測定されたパッケージ又はスタックの面積で割った値です。

の輸出管理を強化する旨を発表し¹³、①両用品目（全般）について、米国軍事ユーザー又は軍事用途への輸出を禁止し、②ガリウム、ゲルマニウム、アンチモン、超硬材料関連の両用品目については、米国への輸出を原則として許可せず、黒鉛の両用品目については、エンドユーザー及び最終用途についてより厳格な審査を行うとし、また、③「いかなる国及び地域の組織及び個人も、上記規定に違反して中国原産の関連両用品目を米国の組織又は個人に移転又は提供した場合は、法律責任を追及する」とする対抗措置を速やかに講じています。

2025 年 1 月 20 日に大統領に就任したトランプ氏は、バイデン政権下で行われていた政策を 180 度転換する大統領令等を次々と発出していますが、輸出管理の分野においては、従前行われていた対中国向けの輸出規制の厳格化が今後も継続することが予想されており、それに対抗した中国側の対米国向けの輸出規制も今後過熱していくものと思われます。また、2025 年 1 月に中国企業により発表された生成 AI「DeepSeek」は、米国製の最先端半導体を用いず低コストで高度な生成 AI の開発に成功した点で世界中に衝撃を与えましたが、米国では DeepSeek に対して東南アジアの仲介企業を通じ NVIDIA の先端半導体が生産されていた可能性が指摘・調査されており、昨今の対中国向けの輸出規制の厳格化では未だ不十分である、BIS による取り締まり・執行をより強化すべきであるとの機運も高まっています。このような状況下に置いて、米国及び中国の企業との取引関係がある日本企業においては、常に輸出管理規制の最新動向を注視し、自社のサプライチェーンについて継続的なモニタリング・厳格な管理を実施することが求められています。

2025 年 3 月 5 日

¹³ 中国商務部による輸出管理強化の詳細は、当事務所発行の[アジア最新法律情報 No.216「両用品目輸出管理条例の施行について（追記：12 月 3 日付け米国向け両用品目輸出管理強化の商務部公告）（中国）」](#)（2024 年 12 月）をご確認ください。

[執筆者]



塚本 宏達

(Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP 弁護士・ニューヨーク州弁護士 パートナー)

hironobu_tsukamoto@noandt.com

京都大学法学部及び The University of Chicago Law School 卒業。05 年～07 年 Weil, Gotshal & Manges LLP (シリコンバレー) 勤務。雇用関連法と知的財産法の分野を中心として国内外の依頼者に対しリーガルサービスを提供するほか、会社法関連紛争、不動産取引関連紛争等、企業活動に関連する多様な紛争案件の代理経験も豊富に有する。また、海外訴訟のマネジメントや国際仲裁案件の代理といった国際紛争対応も行っている。IBA Diversity and Equality Law Committee の Senior Vice Chair (2024 年)。



伊佐次 亮介 (Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP 弁護士・ニューヨーク州弁護士)

ryosuke_isaji@noandt.com

2012 年東京大学法学部卒業。2014 年東京大学法科大学院修了。2015 年弁護士登録 (第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2022 年 Columbia Law School 卒業 (LL.M., James Kent Scholar)。2022 年より長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク・オフィス (Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP) 勤務。

国内外の M&A、TMT (Technology, Media and Telecoms) 分野の取引・紛争を中心に、現在はニューヨークを拠点として企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

www.noandt.com

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU NY LLP

450 Lexington Avenue, Suite 3700

New York, NY 10017, U.S.A.

Tel: +1-212-258-3333 (代表) Fax: +1-212-957-3939 (代表) Email: info-ny@noandt.com



Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP は、米国における紛争対応や日米間の国際取引について効率的な助言を行うことを目的に、長島・大野・常松法律事務所のニューヨーク・オフィスの事業主体として 2010 年 9 月 1 日に開設されました。米国の法務事情について精緻な情報収集を行いつつ、米国やその周辺地域で法律問題に直面する日本企業に対して、良質かつ効率的なサービスを提供しています。

長島・大野・常松 法律事務所

〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 J P タワー

Tel: 03-6889-7000 (代表) Fax: 03-6889-8000 (代表) Email: info@noandt.com



長島・大野・常松法律事務所は、約 600 名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ*及び上海に拠点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

(*提携事務所)

NO&T U.S. Law Update ～米国最新法律情報～の配信登録を希望される場合には、
<https://www.noandt.com/newsletters/nl_us_law_update/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い合わせ等につきましては、<newsletter-us@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承くださいませようお願いいたします。